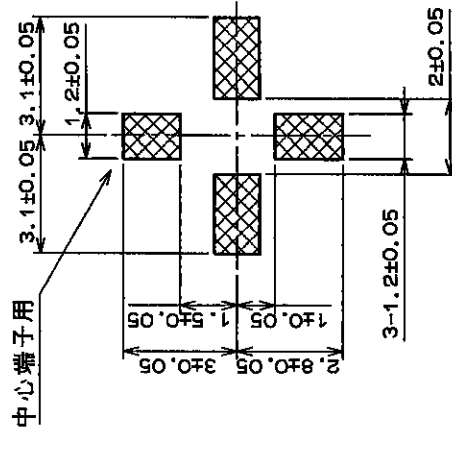
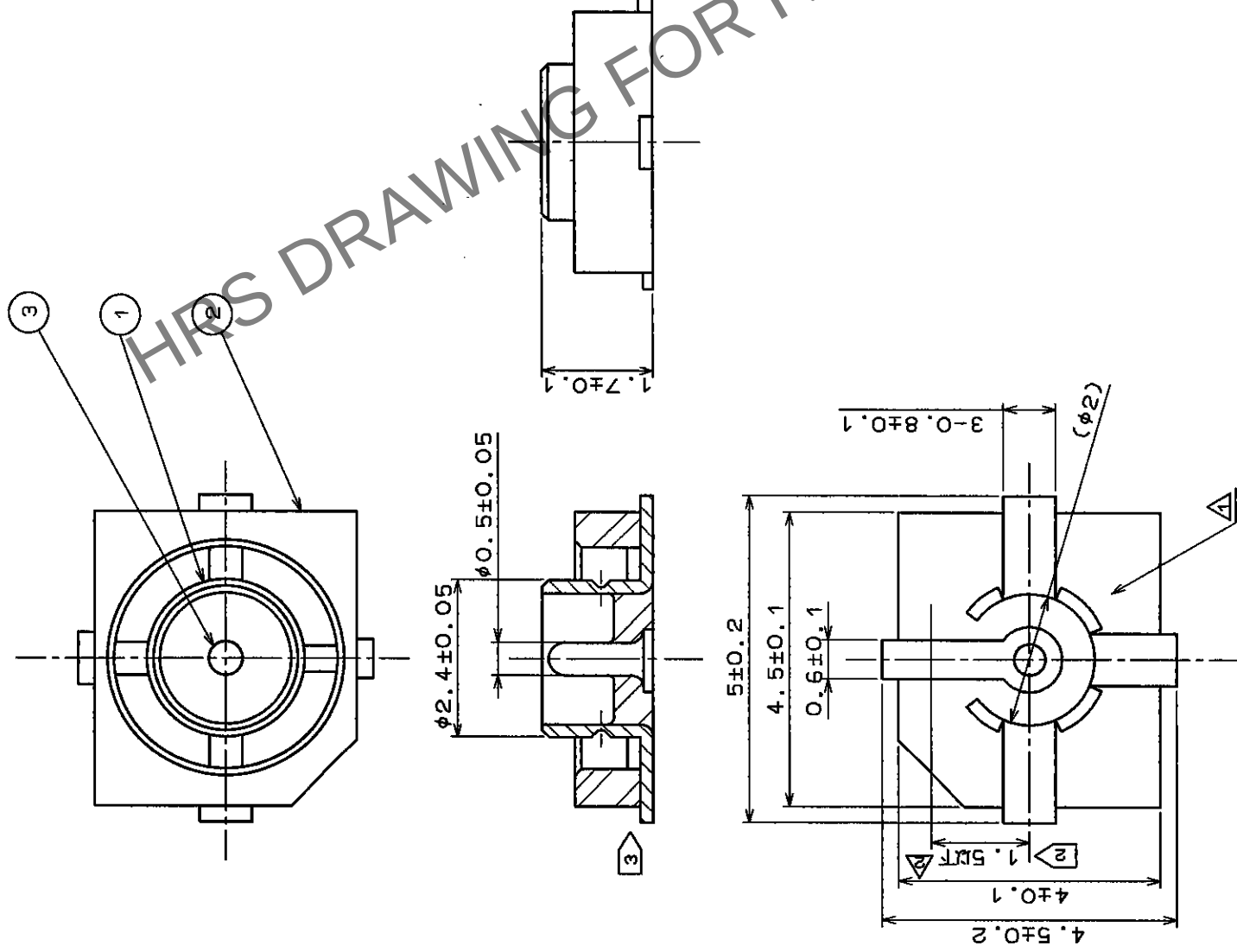


△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当校図 BY CHKO	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当校図 BY CHKO	年月日 DATE
△ 3	RE-D-1204	長島 三谷	92.08.29	△ 3	RE-D-1410	小松 三谷	93.02.24
△ 3	RE-D-2349	小松 三谷	95.11.10				



△ 推奨基板パッド図
(尺度5:1)

2	LCP樹脂 (クロ)	UL94V-0	3	黄銅	金めっき
1	りん青銅	銀めっき			
部番	材質	処理	備考	部番	材質
備考	REMARKS				
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL399-6454-8	図番 DRAWING NO. △ADC3-046538	製品名 PART NO. H.FL-R-SMT(O1)△	製図 DRAWN 92.05.12 小松	校図 CHECKED 92.05.13 三谷	承認 APPROVED 92.05.13 小林
製品コード CL331-0521-6-01△	製品コード CODE NO. CL331-0521-6-01△	製品名 PART NO. H.FL-R-SMT(O1)△	製図 DRAWN 92.05.12 小松	校図 CHECKED 92.05.13 三谷	承認 APPROVED 92.05.13 小林

△注1 H.FL-R-SMT(O1)はパック販売(100KO/パック)となります。
△注2 ③中心端子にモールドの樹脂がかかる許容値を示します。
△注3 SMTリード部先端の平坦度は0.1以下とする。

TO
RF